



中华人民共和国国家标准

GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007
代替 GB/T 17207—1998

电子设备用固定电容器 第 18-1 部分：空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定 电容器 评定水平 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—
Part 18-1: Blank detail specification—
Fixed aluminium electrolytic surface mount
capacitors with solid(MnO₂) electrolyte—
Assessment level EZ

(IEC 60384-18-1:2007, IDT)

2012-11-05 发布

2013-02-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
空白详细规范	1
1 一般资料	3
1.1 推荐的安装方法(应填入)	3
1.2 尺寸	3
1.3 额定值和特性	3
1.4 规范性引用文件	4
1.5 标志	4
1.6 订货资料	4
1.7 放行批证明记录	4
1.8 附加内容(不作检验用)	4
1.9 补充或提高总规范和(或)分规范中所规定的严酷等级或要求	4
2 检验要求	5
2.1 程序	5

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

《电子设备用固定电容器》系列国家标准分为如下若干部分：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器(IEC 60384-3:2006)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 MnO₂ 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ (IEC 60384-3-1:2006)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电解电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998,第 1 号修改单:2000)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4:2000)；
- 第 4-2 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电解电容器 评定水平 EZ(SJ/T 11068-96/IEC 60384-4-2:1985)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(GB/T 14004—1992/IEC 60384-6:1987)；
- 第 6-1 部分：空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-6-1:2005)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E (GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2012/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 (IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 12 部分：分规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 10679—1995/IEC 60384-12:1988)；
- 第 12-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E (GB/T 10680—1995/IEC 60384-12-1:1988)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(IEC 60384-13:2006)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E

- (IEC 60384-13-1:2006);
- 第 14 部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 14472—1998/IEC 60384-14:1993,第 1 号修改单:1995);
 - 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 14473—1998/IEC 60384-14-1:1993);
 - 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽固定电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982,第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
 - 第 15-1 部分:空白详细规范 固体电解质钽箔固定电容器 评定水平 E(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
 - 第 15-2 部分:空白详细规范 固体电解质烧结钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 2795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
 - 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽固定电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1984);
 - 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器(IEC 60384-16:2005);
 - 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(IEC 60384-16-1:2005);
 - 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器(IEC 60384-17:2005);
 - 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯薄膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 EZ(IEC 60384-17-1:2005);
 - 第 18 部分:分规范 表面安装固体和非固体电解质铝电解固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
 - 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
 - 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝电解质固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
 - 第 19 部分:分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质片式直流固定电容器(IEC 60384-19:2006);
 - 第 19-1 部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质片式直流固定电容器 评定水平 E(IEC 60384-19-1:2006);
 - 第 21 部分:分规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
 - 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
 - 第 22 部分:分规范 表面安装多层 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
 - 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本标准作为电子设备用固定电容器系列国家标准的第 18-1 部分。

本标准使用翻译法等同采用 IEC 60384-18-1:2007《电子设备用固定电容器 第 18-1 部分:空白详细规范:表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ》。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB/T 2693—2001 电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范(IEC 60384-1:1999,idt)

GB/T 17206—1998 电子设备用固定电容器 第 18 部分:分规范:固体和非固体电解质片式铝电

解固定电容器(IEC 60384-18:1993, idt)

为了方便使用,对 IEC 60384-18-1:2007 进行了下列编辑性修改:

- 删除了 IEC 60384-18-1:2007 前言部分;
- 表中的脚注采用小写英文字母。

本标准是对 GB/T 17207—1998 进行的第一次修订。本标准与 GB/T 17207—1998 相比,主要变化如下:

- 产品名称改为表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定电容器;
- 评定水平由 E 改为 EZ;
- 增加了 A0 分组检验;
- 增加了可焊性试验方法;
- 增加了耐焊接热试验中温度曲线的要求。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所(CESI)。

本标准主要起草人:张玉芹。

电子设备用固定电容器
第 18-1 部分:空白详细规范
表面安装固体(MnO₂)电解质铝固定
电容器 评定水平 EZ

空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,它包括对详细规范的格式、编排和最少内容要求。不遵守这些要求的详细规范,认为是不符合电子元件质量评定体系要求的标准。

制定详细规范时应考虑分规范 1.4 的内容。

首页括号中数字标注的位置上应填写下列相应内容:

详细规范的识别

- (1) 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。
- (2) IEC 或国家的详细规范标准编号,发布日期以及国家标准体系所要求的任何其他的内容。
- (3) IEC 或国家的总规范编号及其版本号。
- (4) IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

电容器的识别

- (5) 该类型电容器的简要说明。
- (6) 典型结构的信息(适用时)。

注:当电容器不是设计用于印制电路板时,在详细规范的这个位置上应该明确地加以说明。

(7) 影响互换性的主要尺寸的外形图,和(或)引用国家标准或国际文件的外形图。这种图形也可以在详细规范附录中给出。

- (8) 应用或涉及的应用类别和/或评定水平。

注:详细规范中采用的评定水平应从 IEC 60384-18 分规范的 3.5.4 中选取。这就意味着只要试验的分组不变,几个评定水平可以共用一个详细规范。

- (9) 重要特性的参考数据,以便在各种类型电容器之间进行比较。